



电子行业周报：Q2 核心龙头业绩耀眼 行业基本面向上延续



行业景气度回升与国产替代双轮驱动，IC 设计板块 Q2 业绩亮眼。我们选取 23 家芯片设计公司，2021Q2 营收 226.26 亿元，同比增长 69.1%，归母净利润 55.9 亿元，同比大增 111%，2021Q2 综合毛利率环比再提升 3.6%达到 47.5%，Q2 净利率 28.5%，当前行业库存仍处于历史底部。研发投入带来的新品迭代和品类扩张是科技企业之本，这一点在轻资产运营、下游创新需求迭代快的 IC 设计公司上体现的尤为明显。我们欣喜地发现，国内已经出现了一批优质公司在新产品、新技术工艺、市场份额以及客户方面取得重大突破，研发转化加速落地！

全球核心晶圆厂 2021Q2 业绩普遍超预期，出货量、ASP 环比持续上升，产能利用率满载，2021H2 行业 ASP 有望继续上行。SMIC2021Q2ASP 环比提升 9%，UMC 环比提升 5%，UMC 表示 2021Q3 将继续提升 6%。TSMC 和 SMIC 此前分布宣布了今年 300+ 亿美金和 43 亿美金的巨额资本开支，本季度 UMC 表示未来 1~2 年将尽快达到每个季度 10 亿美金的资本开支。UMC 表示行业供不应求现象在 2023 年末未必能减少，目前行业扩产仍处于良性状态。

封测行业稼动率持续满载，封测链条紧张或将延伸至 2023 年。海外封测大厂日月光、安靠营业收入均超预期，日月光预计 2021H2 毛利进一步提升，2022 年需求强劲，长期服务协议延伸至 2023 年，预计供需最快在 2023 年平衡。国内核心封测公司 2021Q2 归母净利润 22.7 亿，同比大增 246%，环比+138%，封测产业链受限于设备、基板、引线框等原因，

行业供不应求持续加剧。

半导体设备核心公司在手订单饱满，国产化主线加速推进。ASML 单季度收入 40 亿欧元，新增 83 亿欧元订单（其中 EUV 为 49 亿欧元）。单季度 BB 值创 2017 年以来最高，累计在手订单 170 亿欧元，供货延期将持续到 2022H2。2021Q2 核心设备公司的归母净利润已达到 12.4 亿元，相比 20Q2 的 6.7 亿元和 21Q1 的 9.1 亿元，均有显著提升。设备行业持续处于高速增长，国产替代空间快速打开，国内核心设备公司有望加速成长！

国产半导体材料品类客户扩张迅速，充分受益景气+国产化双主线。2021 年上半年我们选取的 13 家半导体材料公司营收同比增长 45%；归母净利润同比增长 34%，环比持续改善，21Q2 环比增长 103%。2020 年及 2021 年上半年各公司披露业绩后，我们可以看到随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善，在材料领域已经开始涌现出各类已经进入批量生产及供应的厂商。鼎龙股份 CMP 抛光垫全面切入客户，彤程新材 IC 光刻胶持续放量，兴森科技 IC 载板持续扩产放量，上海新阳 KrF 突破且获得订单，中国半导体材料厂商国产化进度全面加速。此外随着半导体晶圆扩产的制程及尺寸升级，有望看到材料价量齐升，带动市场进一步增长。

从我们最新跟踪的全球科技龙头业绩及近况，核心制造环节龙头（晶圆、封测）持续满载、扩大 capex，年内晶圆 ASP 有望继续上行，封测满载可见度延伸至 2023 年。上游晶圆设备、封测设备 BB 值快速提升，设备

交期延长，部分设备在手订单超过一年。主导汽车、工控领域的海外 IDM 如 NXP、ST、Renesas 普遍面临产能不足、订单积压、库存低位等现象。全球电子产业马上进入三季度旺季，景气加速，行业供需缺口放大，供应链、产能、订单、库存多环节紧张和景气仍将持续。

高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：

1) 半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及 IP 等产业机会；2) 半导体代工、封测及配套服务产业链；3) VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；4) 苹果产业链核心龙头公司。

相关核心标的见尾页投资建议。

风险提示：下游需求不及预期；中美贸易摩擦。

关键词: ST 芯片 苹果

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34881

